

锦州神工半导体股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。

公司积极落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益。

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，总结 2024 年度方案执行情况，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要内容如下：

一、聚焦做强主业，提高核心竞争力

神工股份自成立以来一直专注于大直径硅材料及其应用产品的生产、研发及销售。凭借多年的积累和布局，公司在大直径硅材料领域继续保持领先地位，掌握了 22 英寸及以下尺寸晶体的所有技术工艺，是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商。能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大直径硅材料产品，在全球细分领域处于第一梯队。2024 年，公司大直径硅材料业务，实现营业收入 17,404.39 万元，同比增长 108.32%；毛利率为 63.85%，同比增加 13.73 个百分点；硅零部件产品实现收入 11,849.41 万元，同比增长 214.82%。

2025 年，公司将进一步聚焦主营业务，提高核心竞争力：

1、抓住半导体景气恢复的发展机遇，加强市场营销工作

世界半导体贸易统计协会数据显示，2024 年全球半导体市场规模为 6,280 亿美元，同比增长 19.10%。进入 2025 年，全球领先的集成电路制造厂商和半导体制造设备厂商已经展开预测，台积电、Lam Research 等厂商预计今年全球半导体市场将继

续景气恢复势头。公司的大直径硅材料及其加工制成品即硅零部件产品，其下游需求与终端用户集成电路制造厂商的产能利用率和新增产能密切相关，目前仍是全球半导体产业的发展机遇期。

公司将积极响应快速增长的国内市场多元化需求，在地驻点，贴近客户生产实际，提高反馈速度，前瞻部署市场资源，整合完善技术、质量、物流服务，进一步提升客户满意度；在海外市场落子布局，积极跟踪最新技术发展需求，以自身优势与海外合作伙伴协同发展，进一步提升公司的国际市场地位。

2、优化运营管理，提高经营质量和效率

2025年，公司将进一步做好订单回款收款管理工作，积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，根据信用风险评估减少或停止对特定客户的销售；

存货周转方面，2024年，由于公司战略业务半导体大尺寸硅片产品评估认证周期较长，因此平均产能利用率有限。公司积极争取订单，兼顾评估认证需求和经济效益，优化排产计划，及时调整生产经营计划，降低了库存水平。2025年，公司将继续优化排产计划，严格库存管理，不懈追求研发验证和经济效益的最优平衡。

3、加强募投项目管理、实现新建产能如期投产

2023年，公司以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额约29,606万元，投入“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”21,000万元，补充流动资金9,000万元，不足部分由公司以自筹资金解决。

该项目是在硅片的大尺寸化、制程工艺的缩小推动刻蚀用硅材料需求不断提升，公司大直径硅材料产品的整体产能利用率在高行业景气度条件下会处于基本饱和状态以及半导体行业下一轮上行周期到来前存在项目建设窗口期的背景下进行的产能扩充举措。该项目将根据下游市场需求不断优化产品结构，进一步提升毛利率较高的16英寸及以上大直径产品占比，同时积极拓展刻蚀用多晶硅材料产品业务，以进一步提高盈利能力。项目实施后，将形成新增年产393,136kg刻蚀用硅材料的生产能力。

2024年，该项目处于工程施工和设备安装阶段。公司大直径硅材料产品生产情况稳定，产能逐步提升中，产品结构继续优化升级，利润率较高的16英寸以上产品收入占比进一步提升，从2023年度的39.01%提升至2024年度的51.61%。

2025年，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并实现预期效益。

二、共享发展成果，完善投资者回报机制

公司认为，良好的投资者回报是企业立足资本市场取得长远发展的基石。自2020年在上海证券交易所科创板上市以来，公司连续三年进行现金分红，回报全体股东：

2020年度，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利16,000,000元，占2020年度归属于上市公司股东净利润的15.74%；2021年度每股派发现金红利0.41元（含税），共计派发现金红利65,600,000元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.68%；2022年度每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利16,000,000元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的10.12%。

2023年4月24日，公司制定并披露《锦州神工半导体股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，根据各股东持有的公司股份比例进行分配。公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，在满足相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式。在无重大投资计划或重大现金支出计划，不影响公司正常经营发展需要，公司当年实现的净利润为正数、当年末累计未分配利润为正数、资本公积为正数，且满足相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。

2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税）。截至公告日，公司总股本170,305,736股，扣除回购专用账户950,416股，合计拟派发现金红利12,701,649元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.87%。该利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

股份回购方面，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2023年11月开始实施A股股份回购。至回购期满，公司累计回购A股股份950,416股，占公

司总股本的 0.5579%，成交总金额约为 28,595,409.90 元（不含交易税费）。

2025 年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

三、加快发展新质生产力，创新配置生产要素

公司将以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

强大的人才供给是科技型企业的动力之源。公司以岗位价值和能力为导向，以绩效成绩为牵引，建立“内具公平，外具竞争”的薪酬体系，提高薪酬资源的使用效率，激励绩效优秀员工，鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策，从而达到吸引优秀人才的目的。

2025 年，公司将继续加强人才发展战略，优化人才激励机制、保持科研团队稳定，以限制性股票激励计划作为常态化的激励机制，继续引进具备丰富生产、管理经验的复合型专家和技术人员，扩充到现有的中、高级管理人员团队，加强建设高水平人才梯队，持续提升人才竞争优势；持续优化、迭代现有绩效考核机制，完善公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，不断强化以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，激发人才工作积极性，实现公司和员工双赢。

公司持续加强产品的研发投入，公司的研发投入以盈利为根本目标，基于下游客户端具体明确的评估认证要求来开展研发活动。公司 2022 年至 2024 年的研发投入占当年营业收入的比例分别为 7.30%、16.64%、8.26%。公司累计获得发明专利 12 项、实用新型专利 86 项。

2025 年，公司将激发研发与市场、供应链、客户服务的协同效应，在满足本土市场产业链安全需求的同时与世界先进半导体制造工艺需求保持同步，不断加强技术储备，构建核心竞争力。聚焦资源投入高门槛、高毛利产品，开展大尺寸硅材料、高端制程所需硅零部件等产品相关的技术研发，提高研发投入的产出效益；强化研发体系，积极巩固并加强中国本土技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势，年内完成不少于 3 项关键核心技术研发。

在“全球分工、自由贸易、效率优先”与“芯片制造本土化”并存的产业形势下，公司考虑在内生成长的同时，通过投资或合作开发的形式创新配置生产要素，与国内外高端半导体材料及零部件厂商协同成长，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。

四、提升信披质量，加强投资者沟通

公司证券办公室为公司与投资者沟通的专职部门。自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。2024年度，公司召开业绩说明会2次，借助新媒体开展投资者关系管理活动2次，线下投资者交流2次，相关投资者关系活动记录表已及时披露。

2025年，公司将严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：

1、投资者线上交流活动

未来，公司将继续保持与投资者积极的线上交流，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。每年通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于4次投资者线上交流会，确保交流会于定期报告发布后一周内举行，公司董事长、总经理等主要负责人将积极参加有关活动。

2、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略，加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的信任。

五、深化公司治理，保障规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、加速落实独立董事制度改革

公司将加速落实独立董事制度改革，优化审计机构选聘和内部审计管理，进一步加强分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。

2、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，年内完成对公司管理体系的更新。

3、管理层自律合规

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，约束职务消费行为，不向其他单位或个人输送利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

4、董监高相关培训

公司董监高积极参与证监会、上交所等监管机构举办的各类培训，加强学习证券市场相关法律法规，不断提升自律合规意识，推动公司持续规范运作。公司未来将全力鼓励协助董监高积极参与相关培训。

六、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织相关方参加了上市公司规范运作案例解析暨风险防范、“大股东及董监高诚信义务”相关培训，及时通报最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；按季度跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2025 年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，引导股东长期投资，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加上交所、证监局等监管机构举办的各种培训，及时传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。努力引导“关键少数”通过承诺不减持、增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实

履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2025年3月25日